

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	7.50	0.00
3	10.00	2.50
4	12.50	5.00
5	15.00	7.50
6	17.50	10.00
7	20.00	12.50
8	22.50	15.00
9	25.00	17.50
10	27.50	20.00
11	30.00	22.50
12	32.50	25.00
13	35.00	27.50
14	37.50	30.00
15	40.00	32.50

A

B

C

D

E

F

G

A

B

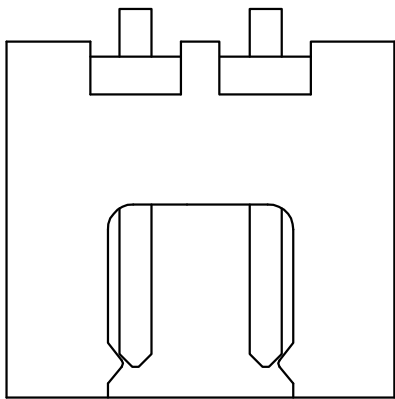
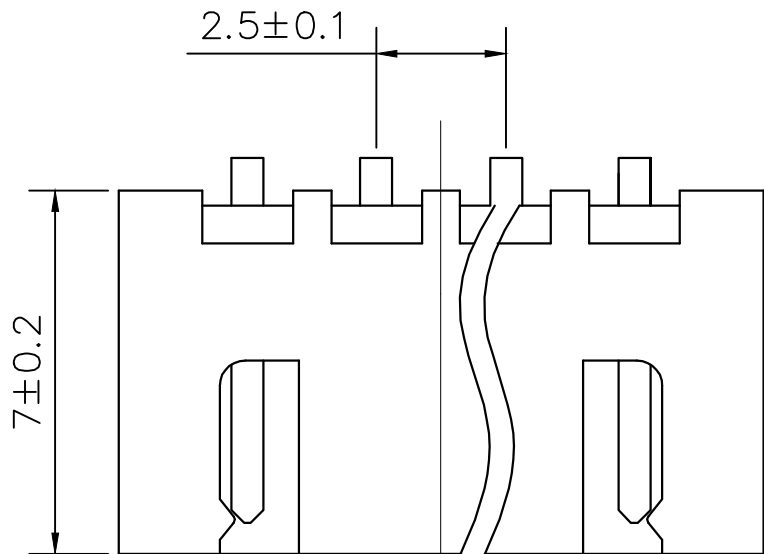
C

D

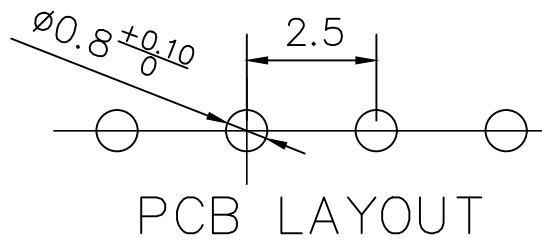
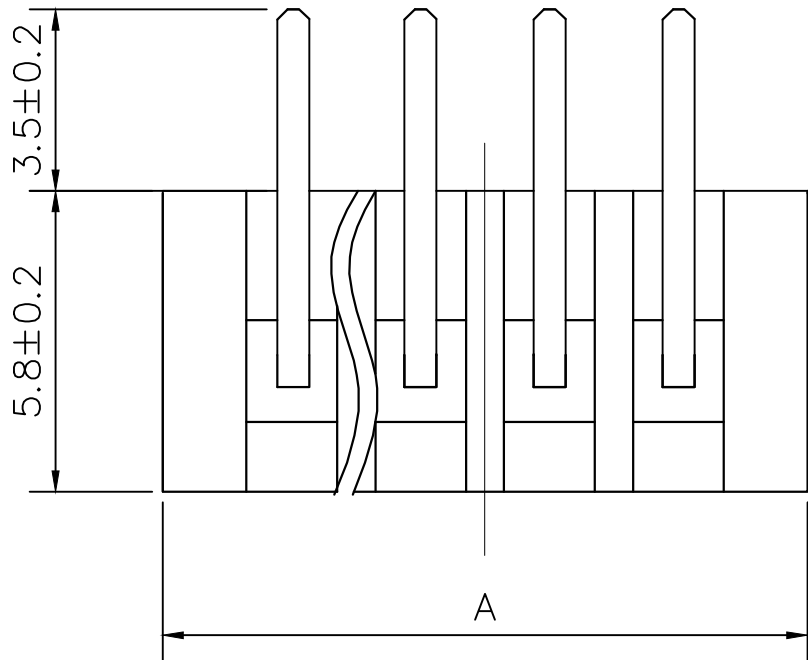
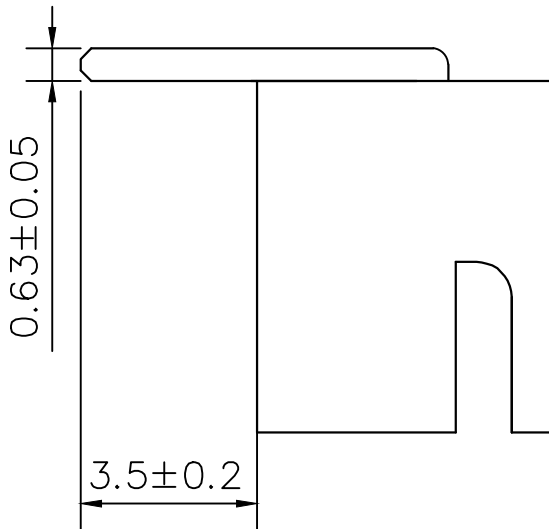
E

F

G



2PIN

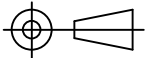


PCB LAYOUT

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 3A
接触电阻: ≤0.01Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
		料 号 PART NO	HC-XH-8AW-TW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X* ±3.00*	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X* ±2.00*	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX* ±1.00*	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				夏操云
				赵亮亮

